

证券代码：301095

证券简称：广立微

杭州广立微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 线上交流 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	银华基金、南方基金、兴全基金、中信保诚、荷宝基金、中信证券、海通证券、财通证券、华安证券、国金证券、安信证券、中邮证券、国元证券、晶石基金、久胜基金、巨鹏资产、维引资本、宝隼资产、杭州济海、嘉实基金、巨曦资产、国禾基金、中金资管、凯昇资本、野村东方、观富资产、新韩资产、万泰华瑞、誉华资管、财联社共 30 家机构。。
时间	2023 年 7 月 10 日-2023 年 7 月 28 日
地点	公司会议室
形式	现场会议
公司接待人员	董秘兼财务总监：陆春龙 证券事务代表：李莉莉
交流内容及具体问答记录	一、公司概况 <p>广立微是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公司现已形成 EDA 设计软件、WAT 测试设备及半导体数据分析工具相结合的成品率提升全流程解决方案，在</p>

集成电路从设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升。

二、问答环节

1、公司在 EDA 软件及电性测试设备研发上的进展情况如何？

公司专注于制造类 EDA 软件及电性测试领域，提供以电性检测为手段的成品率全流程解决方案。

公司在业务发展和规划上定位清晰，并持续加大研发投入力度，在软件上围绕成品率提升业务、利用软硬件协同的优势加深工艺监控（PCM）方案的研发和推广，同时不断开拓新品类的 EDA 软件，在可制造性（DFM）系列产品上取得了阶段性的成果，后期将陆续会有相关产品发布；另一方面，公司不断深化开发贯穿产业链的半导体离线数据平台，除半导体通用化分析工具 DE-G、集成电路良率分析与管理系统 DE-YMS 以外，今年上半年正式发布了集成电路缺陷管理系统 DE-DMS，目前正在研发半导体设备异常监控及分类系统 DE-FDC 等。

在硬件方面，公司自 2022 年开始优化升级 WAT T4000 机型，近期已发布新一代 T4000 系列通用型高性能半导体参数测试系统，相比市场上同类设备，升级版的 T4000 系列测试每片晶圆所需的时间大幅度缩短，提升幅度达 20%至 200%，具有很高的性价比，更适合对成本较为敏感的 8 英寸及以下产线。因其功能全面、稳定性高、兼容性好，不仅可以用于新的产线，还可用于替代原有晶圆厂老旧的测试设备；同时，面对车规电子、第三代半导体等芯片对可靠性测试需求的增大，公司正在研发可靠性（WLR）设备及大功率、高电压类晶圆级电性测试设备并已完成初步开发。

未来，我们将构建贯穿集成电路全产业链的软硬件一体化产品生态，补齐制造类 EDA、完善智能化数据系统产品，

同时不断增加电性测试设备品类，不断构筑更高的技术和市场竞争壁垒，助力公司业务稳健增长。

2、公司的 EDA 软件是否有结合应用到人工智能等相关先进的计算机技术？

AI 技术是一种通过计算机和机器学习等技术手段来模拟和实现人工智能的一种技术，它的基础是计算机科学和机器学习。业界普遍认为，EDA 软件作为工业用软件的一种类型，AI 技术可以帮助提升 EDA 工具效率及分析精度。公司自 2022 年开始已经将机器学习、神经网络等技术应用于公司的半导体数据平台，并在持续深入应用中。面对海量的数据，先进的计算机技术发挥了重要作用，举例来说，在半导体制造过程中，通过物理检测产生大量的图片，这些图片直接反映了芯片表面的平整度、制造过程中的缺陷等信息，依赖人工对这些不同种类的缺陷进行分类，需要有经验的工程师花费相当长的时间，在引入人工智能技术后，可以极大地提高分类效率且精确度在 99%以上，能够帮助客户高效定位影响成品率的根因。未来，公司将逐步探索相关计算机技术并应用到流程设计、模型调参等场景，以不断提升 EDA 软件的产品性能和设计效率。

3、对比 2022 年底，公司的人员增速如何，烦请介绍一下主要研发人员职责分类？

2022 年底公司总人数 318 人，其中研发人员占比约 80%，硕士以上研发人员超过 50%。公司目前的人员总数较年初增长超过 40%以上，研发人员占比略有上升，其中超过三分之二的研发人员为软件开发人员，其余研发人员为硬件设备开发人员。随着公司在 EDA 软件、测试设备硬件等方面产品和技术的进一步横向拓展研发，公司客户群体及销售订单的不断增长，公司的人员团队将进一步扩大规模。

	<p>4、公司 EDA 软件的竞争优势有哪些？</p> <p>首先，公司的 EDA 软件是成品率提升全流程中重要的组成部分，可以单独销售实现其产品价值，也可以和公司其他产品共同销售构成一站式的成品率解决方案；其次，公司的 EDA 软件产品经过十多年的打磨，贴近集成电路制造工艺，在多个工艺节点上都实现了成功验证，具备系统化的设计流程和成熟的模块化功能，这对于制造类 EDA 产品是非常重要的；第三，公司的 EDA 软件采取自主研发的模式，在可寻址测试芯片、超高密度技术、片上测试加速、海量数据分析等多个关键技术已经达到业界领先水平，在成品率提升领域具备核心竞争力；第四，在商业模式上，公司提供软件工具授权与软件技术开发相结合的灵活商业模式，满足客户在成品率提升与保密性等多方面的需求，符合集成电路的产业发展趋势。</p> <p>5、公司数据软件产品的拓展情况如何？</p> <p>公司自 2020 年投入研发半导体数据软件产品，通过与客户之间的深入协同，对原自用的数据分析工具产品进行深化开发和品类拓展，陆续形成了 DE-G、DE-TMA、DE-YMS、DE-DMS 等一系列软件产品，拓宽了公司的客户群体广度，在多家芯片设计、制造及封测客户中试用，且整体进展顺利。半导体数据软件产品是基于公司在良率管理方面的丰富经验和对工艺数据的深度理解，高度贴合客户痛点和需求而开发的全新系列软件产品，得到了客户的高度认可。目前，通过前期较长时间的验证和磨合，与产品试用客户之间已陆续进入商务落地阶段，这将会对公司业绩增长起到积极作用。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无。</p>

活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无。
日期	2023 年 7 月 28 日